



Title of Change:	Update to FPCN2249Y1 E7100 Bump Location Change from Amkor T5 to Amkor T1 to extend Proposed First Ship date.	
Proposed first ship date:	1 December 2018	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Christophe Waelchli <Christophe.WAELCHLI@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Shairoz Rattansi <Shairoz.Rattansi@onsemi.com>	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Paul Syndergaard <Paul.Syndergaard@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>.	
Change Part Identification:	Lots PF3V6200U* or PF3V6200V* with date code 1744. Lots PF3V6200W* with date code 1745 All other lots with date code > 1844	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input checked="" type="checkbox"/> Other <u>Wafer Bump</u>	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Amkor Phil 1/5
Description and Purpose:		
FPCN22249Y was issued on June 2018 announcing that Amkor is consolidating the 12 inch bump manufacturing in one location: T1 that has room for expansion. All equipment is moved from T5 to T1 and the same procedures are used in T1 as are in T5.		
	Before Change Description	After Change Description
Bump location	Bump done in Amkor T5	Bump done in Amkor T1
This update Notification to extend the Proposed first Ship date from September 28, 2018 to December 1, 2018. There is no product marking change as a result of this change.		



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: E7100-A102A19-AG / 0W667-003

PACKAGE: WLCSP

Test	Specification	Condition	Interval	Results
TC+PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +125°C	500 cyc	0/180
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/180
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		

Conclusion: the qualification passed.

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of affected Standard Parts:

Part Number	Qualification Vehicle
E7100-102WC66-AG	E7111-0-102A19-AG E7100-102WC66-AG
E7100-102WC66-BG	
E7110-102A33-AG	
E7110-102A33-BPG	
E7110-4-102A33-AG	
E7110-4-102A33-BPG	
E7111-0-102A19-AG	
E7111-0-102A19-BPG	
E7120-102A59-AG	
E7120-102A59-BPG	
E7150-102A49-AG	
E7150-102A49-BPG	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	E7100 の Amkor T5 から Amkor T1 へのバンパ拠点変更に関する初回出荷予定日の延期にともなう FPCN22249Y1 への更新。							
初回出荷予定日:	2018 年 12 月 1 日							
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Christophe Waelchli <Christophe.WAELCHLI@onsemi.com> お問い合わせください。							
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Shairoz Rattansi <Shairoz.Rattansi@onsemi.com> お問い合わせください。							
追加の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Paul Syndergaard <Paul.Syndergaard@onsemi.com> お問い合わせください。							
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com>にお願いします。							
変更部品の識別:	日付コード 1744 の PF3V6200U* または PF3V6200V* 日付コード 1745 の PF3V6200W* その他はすべて 1844 より大きい日付コードで識別します。							
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <u>ウェハバンパ</u>							
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> その他: _____							
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場または下請け業者拠点: Amkor Phil 1/5						
説明および目的:	<p>FPCN22249Y は Amkor が 12 インチ バンパの製造場所を 1 箇所に統合することを通知するために 2018 年 6 月に発行されました。統合場所は拡張の余地がある T1 です。すべての装置は T5 から T1 に移され、T5 と同じ手順が T1 で使用されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バンパ製造場所</td> <td>Amkor T5 でバンパ製造を実施</td> <td>Amkor T1 でバンパ製造を実施</td> </tr> </tbody> </table> <p>この通知により初回出荷予定日は 2018 年 9 月 28 日から 2018 年 12 月 1 日に延期します。</p> <p>今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。</p>			変更前の表記	変更後の表記	バンパ製造場所	Amkor T5 でバンパ製造を実施	Amkor T1 でバンパ製造を実施
	変更前の表記	変更後の表記						
バンパ製造場所	Amkor T5 でバンパ製造を実施	Amkor T1 でバンパ製造を実施						



信頼性データの要約:

QV 素子名: E7100-A102A19-AG / 0W667-003

パッケージ: WLCSP

テスト	仕様	条件	間隔	結果
TC+PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +125°C	500 cyc	0/180
uHAST+PC	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/180
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		

結論: 認定に合格しました。

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける標準部品の一覧:

部品番号	品質試験用ピークル
E7100-102WC66-AG	E7111-0-102A19-AG E7100-102WC66-AG
E7100-102WC66-BG	
E7110-102A33-AG	
E7110-102A33-BPG	
E7110-4-102A33-AG	
E7110-4-102A33-BPG	
E7111-0-102A19-AG	
E7111-0-102A19-BPG	
E7120-102A59-AG	
E7120-102A59-BPG	
E7150-102A49-AG	
E7150-102A49-BPG	